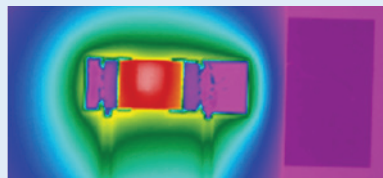




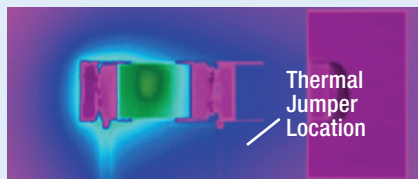
THERMAWick® サーマルマネジメント

電氣的に絶縁された熱伝導体

THJP1206 サーマルジャンパーの例
: 54.3 °Cの表面温度低減



サーマルジャンパーなしの
セラミック抵抗チップ : 149.8 °C



サーマルジャンパーありの
セラミック抵抗チップ : 95.5 °C

利点

高熱伝導性



170 W/mK

電氣的絶縁



> 999 MΩ

低静電容量



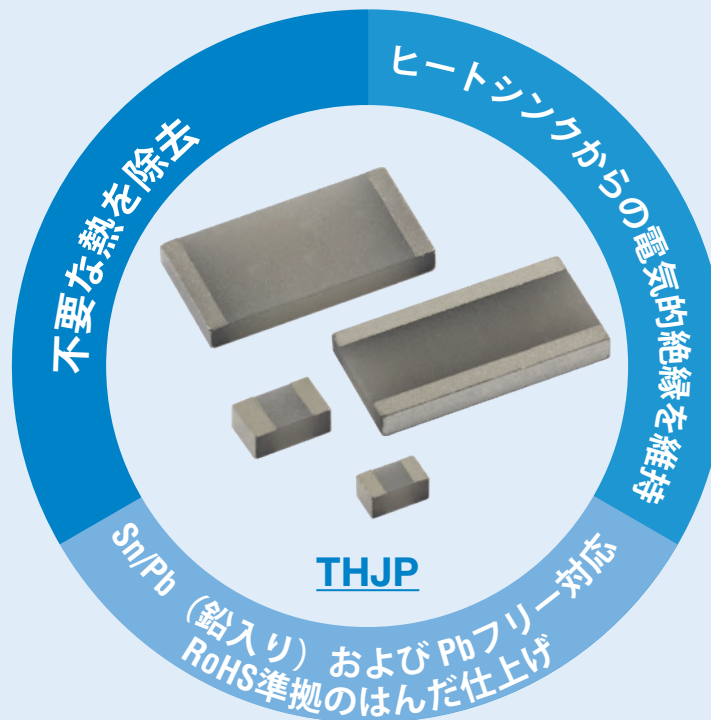
0.26 pF

CASE SIZE	0603	0612	0805	1206	1225	2512
Thermal Resistance (°C/W)	14	4	13	15	4	15
Thermal Conductance (mW/°C)	70	259	77	65	259	65
Capacitance (pF)	0.07	0.26	0.15	0.07	0.26	0.07
Dielectric Withstanding Voltage kV _{AC} , RMS (60 Hz)	> 1.5	> 1.5	> 1.5	> 2.5	> 1.5	> 3.5

thinfilm@vishay.com

www.vishay.com

© 2024 VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. ALL RIGHTS RESERVED.



特長

- 薄膜表面実装端子
- 高熱伝導性
- 高電氣絶縁性
- 低静電容量
- EIA標準サイズ(1608~6432)
- カスタムサイズ対応

用途

- 電源およびコンバーター
- RF アンプ
- シンセサイザー
- スイッチモード電源
- PIN / レーザーダイオード
- フィルター



INDUSTRIAL

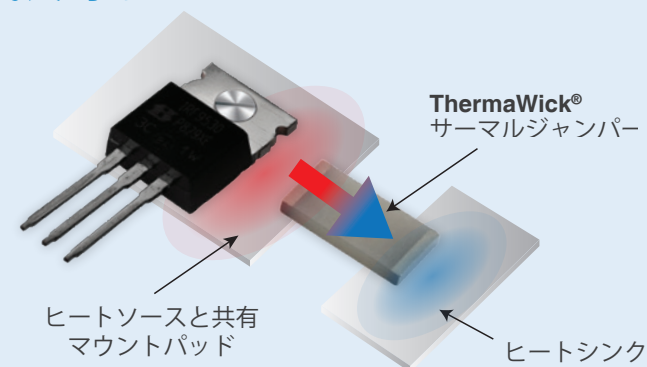


TELECOM



MILITARY

代表的なアプリケーション



IG16843906-2406